



### Toshiba dévoile sa plateforme de développement FFSA™ 130 nm

*Les clients profiteront de performances élevées, d'une faible consommation et de coûts réduits.*

**Düsseldorf, Allemagne, 19 novembre 2018** - Toshiba Electronics Europe ("Toshiba") a annoncé aujourd'hui la toute première livraison de sa nouvelle plateforme de développement FFSA™ (Fit Fast Structured Array) basée sur un procédé de fabrication 130 nm. Cette plateforme de développement de SoC (System on Chip, ou système sur puce) hautes-performances, à la fois innovante et performante, permet d'obtenir des solutions personnalisées à faible consommation et à faible coût.

Toshiba fournit des plateformes ASIC (Application Specific IC, ou CI spécifique) et FFSA™ répondant aux besoins techniques et commerciaux de ses clients, qui sont aussi de bonnes solutions pour le développement de SoC personnalisés. Grâce à une approche innovante, tous les dispositifs FFSA™ disposent d'une couche maîtresse commune en silicium, utilisée conjointement aux couches métalliques supérieures, qui sont réservées et permettent la personnalisation des dispositifs.

La plateforme FFSA™ répond aux exigences des clients en termes de hautes performances et de faible consommation. Toutefois, en limitant la personnalisation aux seuls masques des couches métalliques, cette plateforme permet de réduire considérablement les coûts de développement. Par conséquent, les échantillons comme les dispositifs produits en série peuvent être livrés dans des délais beaucoup plus courts que des ASIC conventionnels. Les clients utilisant la méthodologie de conception et la bibliothèque ASIC FFSA™ sont assurés d'obtenir de meilleures performances et une consommation moindre qu'avec des FPGA (Field Programmable Gate Array, ou circuit prédéfini programmable).

Le nouveau procédé FFSA™ 130 nm s'ajoute à l'offre actuelle de procédés 28, 40 et 65 nm de Toshiba, en offrant une option supplémentaire pour l'équipement industriel. Ce processus de fabrication 130 nm propose différentes tranches maîtresses avec jusqu'à 664 ko de RAM et environ 912.000 portes par dispositif.

Les dispositifs conçus sur cette plateforme seront fabriqués par Japan Semiconductor, une filiale de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ayant une longue et solide expérience dans la fabrication d'ASIC, d'ASSP et de micro-ordinateurs. Ceci garantira la continuité d'approvisionnement à long terme et permettra de répondre aux impératifs des plans de continuité d'activité des clients, voire d'aller au-delà.

Les dispositifs basés sur le nouveau procédé FFSA™ 130 nm offrent les performances et l'intégration nécessaires dans de multiples secteurs, notamment les équipements industriels, les technologies de communication, les équipements bureautiques et bien d'autres.

Suivez le lien ci-dessous pour plus d'information sur cette nouvelle plateforme de développement :

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/custom-soc/platform/ffsa.html>

Notes :

[1] Le nombre de portes disponibles est donné à titre indicatif et peut varier selon l'application.

\* FFSA™ est une marque de commerce de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.

\*Tous les autres noms de société, de produits, et de services, peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

###

## **A propos de Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Tomoaki Kumagai.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

## **Personne à contacter pour les questions concernant la publication :**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0      Fax : +49 (0) 211 5296 79197

Web : [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail : [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

## **Pour des informations concernant la publication, contactez :**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tél : +44 (0) 282 2832

E-mail : [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## **Publié par :**

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0) 20 8429 6554

Web : [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail : [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

